

塗布技術研究会 第 69 回関東定例会

タイトル

ダイ塗布乾燥や、周辺技術としてのフィルム成形のプロセスシミュレーション・物理計測について

発表者

吉田 史志 氏(凸版印刷株式会社)

要旨

これまで、開発の初期の研究段階から製造にわたる多段階において、新生産方式確立や量産時のコストダウンのための、ダイ塗布・乾燥やフィルム成形のプロセス熱流体シミュレーションと、このための物性測定や現象解明のための物理計測に取り組んできた。

本日は、このなかで、①新方式確立のためのダイ内流動解析と、②押出機内挙動解明のための超音波による樹脂の状態評価について、それぞれ(学会発表資料にて)報告する。